

บรรณานุกรม

- เล็ก สีคง , ศิริกุล วิสุทธิเมฆางกูร , ชนินทร์ คำรัสการ , ศรีพงษ์ พรรณแผ้ว. 2546. สมบัติบางประการของวัสดุผสมระหว่างโลหะดีบุกกับซิลิกอนคาร์ไบด์ที่เตรียมด้วยวิธี Mechanical Alloying. รายงานการประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่โลหะวิทยาและปิโตรเลียม รอบครึ่งทาง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 21-22 สิงหาคม 2546 หน้า 75-80
- นภิสพร มีมงคล. 2548. โลหกรรมวัสดุผง. สงขลา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- Lee, B.Z. and Lee, D.N. 1998. Spontaneous growth mechanism of tin whiskers, *Acta Metallurgical Inc*, Vol. 46, No.10, pp 3701 - 3714
- Fukuda, Y. Osterman, M. and Pecht, M. 2007. The impact of electrical current, mechanical bending, and thermal annealing on tin whisker growth. *Microelectronics reliability*. pp. 88-92
- Kim, K.S. Yu, C.H. and Yang, J.M. 2006. Behavior of tin whisker formation and growth on lead-free solder finish, *Thin solid film*. pp. 350-354.
- Brown , R.C. 1993 . *Air filtration an integrated approach to the theory and applications of fibrous filter . 1 ed . Oxford . Pergamon Press*. pp. 12-28 .
- Abtew, U. and Selvadulay, G. 2000. Lead-free solders in microelectronics, *Materials Science and Engineering* , 27 , pp.95-141.
- Tu, K.N. IBM res. Div. Thomas, J. Watson res. Center. 1994. Kinetics of interfacial reaction in bimetallic Cu-Sn thin films., *Physical Review b*., Vol.49, Issue3 . pp. 2030-2034.
- Brusse, J. Ewell, G. and Siplon, J. 2002. Tin Whiskers: Attributes and Mitigation. Capacitor and Resistor Technology Symposium (CARTS). pp. 68-80.
- Chuang, T.H. 2006. Rapid whisker growth on the surface of Sn-3Ag-0.5Ce solder joints, *Acta Materialia*. pp. 983-986
- <http://www.china-shungwei.com> (September, 2550)
- <http://www.genpro.com> (September, 2550)
- <http://www.tytlabs.co.jp> (September, 2550)
- <http://www.cys-pm.co.tw> (September, 2550)

<http://www.nemi.org> (September, 2550)

nepp.nasa.gov/whisker/photos/floor_tile/index.html (September, 2550)

<http://www.gkn-filters.com> (September, 2550)